

お客様へ真のソリューションをご提供するために刷新する展示会

ラージエレクトロニクスショー2011

刷新

・2011 プリントドエレクトロニクス技術展

ラージエレクトロニクスショー2012

NEW

・2012 プリントドエレクトロニクス
最適生産システム展



PE PROCESS 2012
PE 最適生産システム展

ものづくりフェスタ2011

刷新

・夢をカタチに一次世代アプリ開発支援セミナー

ものづくりフェスタ2012

NEW

・次世代アプリ開発支援技術展



次世代アプリ開発支援技術展

2010年の展示会から、JPCA がまとめた「電子回路将来産業ビジョン」の技術的打ち手に代表される幾つか、例えば放熱ソリューションや部品内蔵、高速・高周波対応技術、ラージエレクトロニクスの核となるプリントドエレクトロニクス、LED/OLED 技術や様々な機能性材料・製品技術が各社ブースを中心に会場の至るところで発表・提案されております

2012年もこれらのシーズを国内外のアプリケーションサイドへご理解頂き、実際の機器製品、デバイス、ハードウェアに組み込まれる或いは実際の生産に使用されるような環境を整えるために、JPCA Show 並びにラージエレクトロニクスショーの構成展示会において、ご来場されるユーザが直面する課題解決のために、各展示会を機能別に区分・集積致します。

従来の電子回路基板製造、電子回路実装基板製造技術を核としながらも、アプリケーションサイド（商品設計担当、LSI 製品設計担当）が新製品・新商品を世に出すための比較検討、コストパフォーマンスに優れ、現在の技術よりもより良く、差別化が図れる、又は将来に繋がる情報をスピーディかつリーズナブルに探し出し、出展者とのマッチングを可能とするユーザフレンドリー展示会へと構成展示会を刷新し、横断的技術（機能）テーマ毎のブース或いはゾーン展示を工夫して参ります。

各展示会（構成展示会含む）と横断的機能別展示技術テーマの相関関係

機能別展示技術テーマ	JPCA Show	Printed Tech 2012 2012プリント配線技術展	Module JAPAN 2012 2012年最新ICパッケージ組立技術展	EXIS JAPAN 2012 2012最新・半導体実装生産システム展	ラージエレクトロニクスショー	PE PROCESS 2012 PE 最適生産システム展	Device Engineering 2012 部品・MEMS/デバイス 産業総合資機材展	SS Lighting 2012 LED/OLED 応用技術展	マイクロエレクトロニクスショー	JISSO PROTEC
高放熱対策（サーマルマネージメント）										
高速・高周波 EMI/EMC 対策										
高耐圧対策										
部品内蔵 / 三次元 PKG 化対策										
省エネ・省資源対策										
低コスト化対策										